

2027-2033年中国DPU行业发展潜力预测及投资机会洞察报告

报告大纲

一、报告简介

华经情报网发布的《2027-2033年中国DPU行业发展潜力预测及投资机会洞察报告》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<https://www.huaon.com/channel/semicon/1182673.html>

报告价格：电子版: 9000元 纸介版：9000元 电子和纸介版: 9200元

订购电话: 400-700-0142 010-80392465

电子邮箱: kf@huaon.com

联系人: 刘老师

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

《2027-2033年中国DPU行业发展潜力预测及投资机会洞察报告》由华经产业研究院研究团队精心研究编制，对DPU行业发展环境、市场运行现状进行了具体分析，还重点分析了行业竞争格局、重点企业的经营现状，结合DPU行业的发展轨迹和实践经验，对未来几年行业的发展趋向进行了专业的预判；为企业、科研、投资机构等单位投资决策、战略规划、产业研究提供重要参考。

本研究报告数据主要采用国家统计局数据、海关总署、问卷调查数据、商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：

第一章 DPU行业发展概述

第一节 DPU行业定义与分类

- 一、DPU行业概念界定
- 二、DPU行业分类体系
 - 1、按产品形态分类（芯片/加速卡/智能网卡/板卡模组）
 - 2、按技术架构分类（专用集成电路/可编程门阵列/多核片上系统）
 - 3、按部署位置分类（云侧/智算集群/边缘与电信侧）

第二节 DPU行业发展历程

- 一、海外云厂商自研卸载方案带动需求萌芽
- 二、海外厂商提出数据处理器概念并定义产品形态
- 三、国内创业企业集中涌现推动国产量产落地

第三节 DPU行业商业模式分析

- 一、以芯片与加速卡硬件销售获取主要收入
- 二、直供整机厂商并参与集中采购招标
- 三、配套软件开发平台授权与定制服务收费

第四节 DPU行业进入壁垒分析

- 一、芯片架构与高速网络协议栈能力积累难
- 二、先进制程流片与封装前期投入规模大
- 三、整机与操作系统兼容性认证周期偏长
- 四、云厂商与运营商验证周期长门槛高
- 五、持续融资能力决定多年研发投入强度

第五节 DPU行业退出壁垒分析

- 一、已投片流片的沉没成本难以回收
- 二、客户侧适配与联合开发投入难转移
- 三、核心团队与专利资产处置难度较大

第二章 中国DPU行业发展环境分析

第一节 中国DPU行业政策与法律环境分析

- 一、《算力基础设施高质量发展行动计划》
- 二、《新型数据中心发展三年行动计划》
- 三、《国家集成电路产业发展推进纲要》
- 四、《算力互联互通行动计划》
- 五、《国家数据基础设施建设指引》

第二节 中国DPU行业经济与产业环境分析

- 一、头部云厂商资本开支高速增长拉动芯片需求
- 二、国家集成电路产业基金为芯片设计提供支撑

第三节 中国DPU行业社会与需求环境分析

- 一、大模型训练与推理推动东西向流量激增
- 二、运营商集采转向推理算力与国产化方案

第四节 中国DPU行业技术与创新环境分析

- 一、可编程数据平面与卸载技术日趋成熟
- 二、高速接口与无损网络标准加速迭代

第三章 全球DPU行业发展现状分析

第一节 2022-2026年全球DPU产量规模分析

第二节 2022-2026年全球DPU市场需求分析

第三节 2022-2026年全球DPU市场规模与结构分析

第四节 2022-2026年全球DPU价格走势分析

第五节 2022-2026年全球DPU价格影响因素分析

第六节 全球DPU行业区域分布格局

- 一、芯片设计与软件生态由美国厂商主导
- 二、亚太是增长最快的增量市场与需求中心
- 三、晶圆制造与先进封装产能高度集中

第七节 全球DPU行业区域市场发展分析

- 一、亚太地区DPU行业运行现状及趋势预测
- 二、北美地区DPU行业运行现状及趋势预测

三、欧盟地区DPU行业运行现状及趋势预测

四、其他地区DPU行业运行现状及趋势预测

第八节 全球DPU行业重点区域发展动态分析

一、亚太地区发展动态

1、日本运营商把基带加速功能集成进芯片

2、韩国运营商完成人工智能无线接入网示范

二、北美地区发展动态

1、美国厂商发布新一代数据处理器产品

2、美国厂商联合服务器厂商推出预集成平台

三、欧盟地区发展动态

1、丹麦网卡厂商获得首笔商业量产订单

2、法国芯片企业授权数据处理单元知识产权

第九节 全球DPU行业重点企业分析

一、NVIDIA Corporation

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业DPU业务发展概况

二、Broadcom Inc.

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业DPU业务发展概况

三、Marvell Technology, Inc.

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业DPU业务发展概况

四、Advanced Micro Devices, Inc.

1、企业简介

2、企业经营态势分析

3、企业DPU业务发展概况

第四章 中国DPU行业发展现状分析

第一节 2022-2026年中国DPU行业产量规模分析

第二节 中国DPU行业需求分析

一、DPU需求总量分析

二、DPU需求区域分布格局

第三节 中国DPU行业市场规模分析

一、DPU市场规模分析

二、DPU规模区域分布格局

第四节 2022-2026年中国DPU行业价格走势分析

第五节 2022-2026年中国DPU价格影响因素分析

第五章 DPU行业产业链分析

第一节 DPU行业产业链图谱分析

第二节 上游产业分析

一、晶圆代工与先进封装分析

1、2022-2026年晶圆代工与先进封装发展现状

2、2027-2033年晶圆代工与先进封装发展趋势

二、高带宽存储与交换芯片分析

1、2022-2026年高带宽存储与交换芯片发展现状

2、2027-2033年高带宽存储与交换芯片发展趋势

三、高速光模块与印制电路板分析

1、2022-2026年高速光模块与印制电路板发展现状

2、2027-2033年高速光模块与印制电路板发展趋势

第三节 下游产业分析

一、云计算与互联网分析

1、2022-2026年云计算与互联网发展现状

2、DPU在云计算与互联网的应用分析

3、2027-2033年云计算与互联网发展趋势

二、电信运营商分析

1、2022-2026年电信运营商发展现状

2、DPU在电信运营商的应用分析

3、2027-2033年电信运营商发展趋势

三、金融与政务信创分析

1、2022-2026年金融与政务信创发展现状

2、DPU在金融与政务信创的应用分析

3、2027-2033年金融与政务信创发展趋势

第四节 上下游产业链对DPU行业影响分析

第六章 中国DPU行业七大区域发展概况

第一节 华东地区DPU行业分析及预测

- 一、华东地区区位特征及经济概况
- 二、2022-2026年华东地区DPU市场规模分析
- 三、2022-2026年华东地区DPU市场需求分析
- 四、2027-2033年华东地区DPU市场前景预测
- 第二节 华北地区DPU行业分析及预测
 - 一、华北地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年华北地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年华北地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年华北地区DPU市场前景预测
- 第三节 东北地区DPU行业分析及预测
 - 一、东北地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年东北地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年东北地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年东北地区DPU市场前景预测
- 第四节 华中地区DPU行业分析及预测
 - 一、华中地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年华中地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年华中地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年华中地区DPU市场前景预测
- 第五节 华南地区DPU行业分析及预测
 - 一、华南地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年华南地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年华南地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年华南地区DPU市场前景预测
- 第六节 西南地区DPU行业分析及预测
 - 一、西南地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年西南地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年西南地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年西南地区DPU市场前景预测
- 第七节 西北地区DPU行业分析及预测
 - 一、西北地区区位特征及经济概况
 - 二、2022-2026年西北地区DPU市场规模分析
 - 三、2022-2026年西北地区DPU市场需求分析
 - 四、2027-2033年西北地区DPU市场前景预测

第七章 中国DPU行业市场竞争格局分析

第一节 中国DPU行业竞争主体与梯队格局

- 一、第一梯队为国际巨头掌握架构定义与生态
- 二、第二梯队为本土独立芯片厂商以场景切入
- 三、第三梯队为云厂商与设备商自研方案

第二节 中国DPU行业整体竞争格局与竞争特点

- 一、市场集中度高头部厂商合计份额领先
- 二、海外厂商在国内市场占有率仍然偏高
- 三、产品迭代周期短技术路线尚未收敛

第三节 中国DPU行业竞争五力模型分析

一、现有竞争者之间的竞争强度分析

- 1、国际厂商凭生态锁定云侧市场
- 2、国产厂商在低速率市场以价格竞争

二、潜在进入者威胁分析

- 1、云厂商自研卸载方案对外供货
- 2、交换芯片厂商向网卡环节延伸

三、替代品威胁分析

- 1、处理器核数提升降低卸载必要性
- 2、加速器直连组网替代部分网卡功能

四、供应商议价能力分析

- 1、先进制程与封装产能集中于少数厂商
- 2、高带宽存储与可编程器件供应受限

五、购买者议价能力分析

- 1、云厂商与运营商集中采购压价强势
- 2、行业客户验证周期长替换成本高

第四节 中国DPU行业竞争关键成功要素分析

- 一、芯片性能与包处理能力决定产品竞争力
- 二、软件生态与编程框架成熟度形成粘性
- 三、与国产处理器和整机的适配认证能力
- 四、进入运营商与央企集中采购名录的能力

第五节 中国DPU行业替代品与潜在进入者竞争分析

- 一、通用可编程芯片自研方案替代部分专用需求
- 二、交换芯片内置卸载功能融合压缩独立市场
- 三、纯软件卸载方案替代部分硬件加速需求
- 四、加速器直连组网减少网卡侧卸载依赖

第八章 中国DPU行业主要参与者对比分析

第一节 中科驭数(北京)科技有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营态势分析
- 三、企业DPU业务布局情况
- 四、企业经营优劣势分析
- 五、企业专利及投融资情况
- 六、企业发展战略或业务动态

第二节 深圳云豹智能有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营态势分析
- 三、企业DPU业务布局情况
- 四、企业经营优劣势分析
- 五、企业专利及投融资情况
- 六、企业发展战略或业务动态

第三节 上海云脉芯联科技有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营态势分析
- 三、企业DPU业务布局情况
- 四、企业经营优劣势分析
- 五、企业专利及投融资情况
- 六、企业发展战略或业务动态

第四节 珠海星云智联科技有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营态势分析
- 三、企业DPU业务布局情况
- 四、企业经营优劣势分析
- 五、企业专利及投融资情况
- 六、企业发展战略或业务动态

第五节 北京大禹智芯科技有限公司

- 一、企业基本情况
- 二、企业经营态势分析
- 三、企业DPU业务布局情况
- 四、企业经营优劣势分析

五、企业专利及投融资情况

六、企业发展战略或业务动态

第六节 芯启源电子科技有限公司

一、企业基本情况

二、企业经营态势分析

三、企业DPU业务布局情况

四、企业经营优劣势分析

五、企业专利及投融资情况

六、企业发展战略或业务动态

第七节 苏州盛科通信股份有限公司

一、企业基本情况

二、企业经营态势分析

三、企业DPU业务布局情况

四、企业经营优劣势分析

五、企业专利及投融资情况

六、企业发展战略或业务动态

第八节 成都北中网芯科技有限公司

一、企业基本情况

二、企业经营态势分析

三、企业DPU业务布局情况

四、企业经营优劣势分析

五、企业专利及投融资情况

六、企业发展战略或业务动态

第九章 DPU行业投资风险、发展趋势与策略建议

第一节 全球DPU行业发展趋势

一、全球数据处理器由可选加速卡转为集群标配

二、开放以太网与统一互连标准推动生态重构

第二节 2027-2033年全球DPU行业发展趋势预测

一、2027-2033年全球DPU产量预测

二、2027-2033年全球DPU需求预测

三、2027-2033年全球DPU市场规模预测

四、2027-2033年全球DPU价格走势预测

第三节 中国DPU行业SWOT分析

一、行业优势分析

1、卸载网络存储与安全负载释放算力资源

2、国内配套齐全工程化落地条件良好

二、行业劣势分析

1、关键上游器件受制于高端产品出货受限

2、软件生态薄弱客户迁移意愿偏低

三、行业机会分析

1、人工智能集群建设推动卸载需求转为刚需

2、海外厂商份额高国产替代空间可观

四、行业威胁分析

1、国际巨头以生态锁定压制国产品牌成长

2、云厂商自研方案压缩独立厂商市场空间

第四节 中国DPU行业投资风险预警

一、政策风险预警

1、先进制程设备与存储采购受出口管制影响

2、集采节奏与信创目录调整存在不确定性

二、市场风险预警

1、国际巨头降价挤压国产厂商生存空间

2、下游资本开支波动影响订单稳定性

三、技术风险预警

1、架构路线尚未收敛存在押注失败风险

2、软件生态碎片化抬高客户迁移成本

四、供应链风险预警

1、晶圆代工与先进封装产能获取难度大

2、核心知识产权依赖外购存在断供风险

五、经营风险预警

1、企业普遍处于高研发投入亏损阶段

2、概念炒作损害行业融资环境与信心

第五节 中国DPU行业发展趋势研判

一、国产芯片由单点可用走向规模替代

1、信创与运营商市场成为主要突破口

2、国产方案价格优势加快替代窗口打开

二、需求重心由云侧通用卸载向推理侧扩散

1、推理集群对内存池化需求抬升配卡密度

2、边缘算力节点成为新的采购增长场景

三、与国产处理器和加速器的全栈适配成为前提

1、兼容性认证与物料编码成为准入条件

2、联合方案与场景业绩成为中标关键

第六节 2027-2033年中国DPU行业发展趋势预测

一、2027-2033年中国DPU产量预测

二、2027-2033年中国DPU需求预测

三、2027-2033年中国DPU市场规模预测

四、2027-2033年中国DPU价格走势预测

第七节 中国DPU行业发展战略与建议

一、以国产算力全栈适配绑定确定性需求

1、与国产处理器与整机厂商联合完成认证

2、面向信创场景推出预验证一体化方案

二、以软件生态与开发者框架构建长期壁垒

1、开放开发平台降低客户二次开发成本

2、参与标准与基准评测提升技术话语权

详细请访问：<https://www.huaon.com/channel/semicon/1182673.html>